（上接B493版）

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月20日13点30分

召开地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋苏州东微半导体股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
4	《关于公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于出售参股公司部分股权的议案》	√
7	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	√
9	《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√

注：本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》以及高级管理人员2026年度薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《苏州东微半导体股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案4

应回避表决的关联股东名称：存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688261	东微半导	2026/5/15

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月18日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（二）登记地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋苏州东微半导体股份有限公司董事会办公室

（三）登记方式：

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡原件（如有）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、公司股东或代理人可以用信函、邮件方式进行登记，以信函、邮件方式登记的股东，在函件上请注明“股东会”字样并提供有效的联系方式，请于2026年5月18日17:00前送达公司董事会办公室，恕不接受电话方式办理登记。

5、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

六、其他事项

（一）本次股东会会期预计不超过半天，出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东及股东代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋

联系人：董事会办公室

邮编：215123

电话：0512-62668198

邮箱：enquiry@orientalsemi.com

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州东微半导体股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》			
3	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
4	《关于公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》			
6	《关于出售参股公司部分股权的议案》			
7	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》			
8	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》			
9	《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》			

注：本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》以及高级管理人员2026年度薪酬方案。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2026-013

苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金（以下简称“超募资金”）不超过人民币19,700.00万元（含利息，最终以实际转出为准）用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为18.45%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4040号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16,844,092股，本次发行价格为每股人民币130.00元，募集资金总额为人民币2,189,731,960.00元，扣除保荐承销费155,127,216.60元（不含增值税）后的募集资金为2,034,604,743.40元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年1月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除剩余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用28,048,153.30元后，实际募集资金净额为人民币2,006,556,590.10元。上述募集资金已于2022年1月28日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年1月28日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕42号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2022年2月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据《苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目	20,414.58	20,414.58
2	新结构功率器件研发及产业化项目	10,770.32	10,770.32
3	研发工程中心建设项目	16,984.20	16,984.20
4	科技与发展储备资金	45,700.00	45,700.00
合计		93,869.10	93,869.10

截至2025年12月31日，公司的募投项目及募集资金存放与实际使用情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司拟使用超募资金不超过人民币19,700.00万元（含利息，最终以实际转出为准）用于永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的生产经营。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金共计不超过人民币19,700.00万元（含利息，最终以实际转出为准），占首次公开发行股票超募资金总额（106,786.56万元）的18.45%。公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金将主要用于与主营业务相关的经营活动，符合公司发展的实际需要，不存在损害公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。

公司承诺，每十二个月内累计用于永久补充流动资金和归还银行借款的超募资金金额不得超过超募资金总额的百分之三十；本次超募资金永久补充流动资金后的十二个月内，不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序

2026年4月24日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币19,700.00万元（含利息，最终以实际转出为准）的超额募集资金永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的18.45%。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、专项意见说明

（一）董事会意见

董事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，公司董事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规的要求。综上，保荐机构对公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688261 证券简称：东微半导

苏州东微半导体股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自《苏州东微半导体股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688261
公司简称	东微半导
公司名称	苏州东微半导体股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	1、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》； 2、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》； 3、全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准（GRI Standards）》； 4、中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南（CASS—ESG 6.0）》。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略与ESG委员会

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司建立了由各部门、各分公司-ESG工作小组-董事会战略与ESG委员会分级信息报告机制；公司以年度为周期发布年度环境、社会及公司治理报告。□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为《董事会战略与ESG委员会工作细则》□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东/投资者	利益相关方沟通 尽职调查	股东会（非定期） e互动（非定期） 报告披露（季度） 投资者热线（非定期） 媒体报道（非定期） 业绩说明会（季度） 信息披露（实时）
员工	员工权益与发展 职业健康与安全	内部信息沟通平台（非定期） 电话与邮件（非定期） 面对面沟通（非定期） 员工满意度调查（年度）
供应商	反商业贿赂及反贪污 供应链安全 平等对待中小企业	走访稽核（非定期） 调研问卷（非定期） 商务拜访（非定期） 电话与邮件（非定期）
客户/经销商	产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护 反不正当竞争	专网对接（非定期） 客户满意度调查（年度）
媒体	创新驱动 科技伦理 社会贡献 乡村振兴	媒体采访（非定期） 公司网站（非定期）
政府/监察机构	应对气候变化 环境合规管理 能源利用 水资源利用 污染物排放 废弃物处理 循环经济 生态系统和生物多样性保护	信息披露（月度） 电话与邮件（非定期）

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
2	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
3	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
4	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
5	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
6	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
7	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
8	员工权益与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
9	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
10	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
11	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
12	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
13	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
14	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
15	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题中，生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业、社会贡献、乡村振兴、尽职调查、利益相关方沟通对公司不具有重要性，已结合公司实际情况在报告中进行解释说明。

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2026-014

苏州东微半导体股份有限公司关于出售参股公司部分股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 交易简要内容：

经友好协商，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的苏州德信芯片科技有限公司（以下简称“德信芯片”）7.5758%的股权以人民币4,000.00万元的价格转让给苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”）。

- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。本次交易尚需提交公司股东会审议。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次交易尚需提交公司股东会审议，相关方需按照协议约定支付转让款和办理标的公司股份过户手续，本次交易最终能否成功实施尚存在不确定性。本次交易对方具备履约能力，但依然存在不能按协议约定及时支付股份转让对价的履约风险。本次交易因尚需履行工商变更等手续，尚存在一定的不确定性。公司将持续关注本次出售参股公司股权事项的进展，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

德信芯片为公司参股公司，公司持有其15.1515%股权。为优化公司资产结构及资源配置，提高资产运营效率，公司拟以人民币4,000.00万元的价格将德信芯片7.5758%的股权转让给苏州固锝（标的股权的取得成本和本次转让的价格均为1元/注册资本）。本次交易完成后，公司仍持有德信芯片7.5757%的股权。

本次出售参股公司部分股权是基于公司发展实际情况的综合考虑，如本次交易顺利实施，将有利于整合和优化公司资产结构，提高公司资产运营效率，降低管理成本，为公司业务拓展提供资金支持，增强公司的持续经营能力。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	√出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他，具体为：
交易标的类型（可多选）	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	德信芯片7.5758%的股权
是否涉及跨境交易	□是 √否
交易价格	√已确定，具体金额（万元）：4,000.00 （尚未确定
账面成本	4,000.00万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	不适用
支付安排	√全额一次付清，约定付款时点：确认交割条件已经满足或被豁免后的10个工作日内 （分期付款，约定分期条款：
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售参股公司部分股权的议案》，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及相关人士办理与本次出售股权事项相关的具体事宜。本项议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。

二、交易对方情况介绍

（一）交易买方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例	对应交易金额（万元）
1	苏州固锝	德信芯片7.5758%的股权	4,000.00

（二）交易对方的基本情况

1、交易对方

法人/组织名称	苏州固锝电子股份有限公司
统一社会信用代码	√_91320000681960804L_ □不适用
成立日期	1990/11/12
注册地址及主要办公地址	苏州市通安开发区通锡路31号
法定代表人	吴校鹏
注册资本	人民币81,033.0416万元
经营范围	设计、制造和销售各类半导体芯片，各类二极管、三极管；生产加工汽车整流器，汽车电器部件，大电流硅整流桥堆及高压硅堆；集成电路封装；电镀加工电子元件以及半导体器件相关技术的开发、转让和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东/实际控制人	控股股东：苏州通博电子器材有限公司；实际控制人：吴校鹏

交易对方的主要财务数据如下：

单位：万元

披露主要财务数据的主体名称	苏州固锝电子股份有限公司	
相关主体与交易对方的关系	√交易对方自身 □控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他，具体为	
项目	2024年度/2024年12月31日	2025年度三季度/2025年9月30日
资产总额	417,023.17	386,252.04
负债总额	112,193.25	76,194.98
归属于母公司所有者权益	302,610.68	308,265.74
营业收入	363,795.54	302,037.40
营业利润	7,745.96	6,719.18
归属于上市公司股东的净利润	7,369.10	6,251.60

注：交易对方为深圳证券交易所上市公司（股票代码：002079），资信状况正常，未被列为失信被执行人，具备良好的履约能力，与公司之间不存在产权、资产、债权债务或人员等方面的其它关联关系。

三、交易标的基本情况

本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“出售资产”类别。

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易标的为公司持有的德信芯片7.5758%的股权。

2、交易标的的权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

截至本公告披露日，德信芯片经营状况正常。

4、交易标的具体信息

（1）交易标的

1）基本信息

法人/组织名称	苏州德信芯片科技有限公司
统一社会信用代码	√_91320505MA7JK28Q56_ □不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	□是 √否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	□是 √否
是否存在为该参股公司提供担保、委托其理财，以及该参股公司占用上市公司资金	担保：√是 √否 □不适用 委托其理财：√是 √否 □不适用 占用上市公司资金：□是 √否 □不适用
成立日期	2022/2/22
注册地址及主要办公地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区东长路88号D1幢1层B35-6室
法定代表人	周晓
注册资本	人民币52,800.00万元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子产品销售；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
所属行业	C39计算机、通信和其他电子设备制造业

（2）股权结构

本次交易前股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	苏州固锝电子股份有限公司	9,200	17.4242
2	苏州东微半导体股份有限公司	8,000	15.1515
3	苏州鑫晟管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,000	11.3636
4	中新苏州工业园区创业投资有限公司	5,040	9.5455
5	苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）	3,360	6.3636
6	广州广微欣德管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,000	5.6818
7	广州粤芯集成电路有限公司	3,000	5.6818
8	苏州工业园区集成电路天使基金合伙企业（有限合伙）	2,800	5.3030
9	其他股东	12,400	23.4849
合计		52,800	100.0000

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	苏州固锝电子股份有限公司	13,200	25.0000
2	苏州东微半导体股份有限公司	4,000	7.5757
3	苏州鑫晟管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,000	11.3636
4	中新苏州工业园区创业投资有限公司	5,040	9.5455
5	苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）	3,360	6.3636
6	广州广微欣德管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,000	5.6818
7	广州粤芯集成电路有限公司	3,000	5.6818
8	苏州工业园区集成电路天使基金合伙企业（有限合伙）	2,800	5.3030
9	其他股东	12,400	23.4849
合计		52,800	100.0000

注：注册资本具体以最终工商变更登记结果为准；持股比例以四舍五入方式保留四位小数，合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因所致。

（3）其他信息

①对于本次交易，除苏州固锝外，其他股东未行使优先受让权。

②交易标的及其实际控制人均不属于失信被执行人。

（二）交易标的主要财务信息

1、标的资产

单位：万元

标的资产名称	苏州德信芯片科技有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权出资比例（%）	7.5758	
是否经过审计	2024年年度：√是 □否 2025年年度：√是 □否	
审计机构名称	苏州东恒会计师事务所（普通合伙）	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2024年度/2024年12月31日	2025年度/2025年12月31日
资产总额	70,868.76	82,274.22
负债总额	24,285.93	39,048.25
净资产	46,582.83	43,225.97
营业收入	48.30	77.79
净利润	-4,154.57	-3,356.86

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

本次交易根据具有从事证券、期货业务资格的评估机构江苏中企华中天资产评估有限公司出具的以2025年12月31日为评估基准日的德信芯片资产评估报告，经双方友好协商，确定公司所持有德信芯片7.5758%的股权作价为人民币4,000.00万元。

2、标的资产的具体评估、定价情况

（1）标的资产

标的资产名称	苏州德信芯片科技有限公司
定价方法	√协商定价 √以评估或估值结果为依据定价 （公开挂牌方式确定 （其他：
交易价格	√已确定，具体金额（万元）：4,000.00 （尚未确定
评估/估值基准日	2025/12/31
采用评估/估值结果（单选）	√资产基础法√□收益法□市场法 □其他，具体为：
最终评估/估值结论	评估/估值价值：43,808.09（万元） 评估/估值增值率：1.38%
评估/估值机构名称	江苏中企华中天资产评估有限公司

德信芯片各项资产、负债的内容产权属较清晰，已经过请查盘点并整理成册，与账面记录能够核对，对各项资产负债的物理状况、权属状况等可以勘察辨别，经过比较分析，认为资产基础法能更全面、合理地反映德信芯片的股东全部权益价值，故最终选择资产基础法作为评估方法。

截至评估基准日2025年12月31日，德信芯片已经审计后的总资产账面价值为82,274.22万元，总负债为39,048.25万元，净资产为43,225.97万元。资产基础法评估结果在评估报告所列假设和限定条件下，采用资产基础法评估后的总资产价值82,856.34万元，总负债39,048.25万元，净资产为43,808.09万元，净资产增值582.12万元，增值率1.35%。

除本次交易涉及的资产评估外，最近12个月内未发生其他有关机构对标的公司出具评估报告或估值报告的情况。评估基准日至相关评估结果披露日期间，未发生可能对评估结论产生重大影响的事项。

（二）定价合理性分析

本次交易价格以第三方资产评估机构的评估值为定价基础，并综合考虑当前行业形势、标的公司财务与经营情况等因素，经双方友好协商后确定，标的股权的取得成本和本次转让的价格均为1元/注册资本。本次交易定价具备合理性与公平性，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者的合法权益的情形。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

（一）出售资产协议的主要条款

公司与交易对方签署的《股权转让协议》的主要内容如下：

1、协议主体

转让方：苏州东微半导体股份有限公司

受让方：苏州固锝电子股份有限公司

目标公司：苏州德信芯片科技有限公司

2、股权转让价款及支付

以目标公司资产评估价值（评估基准日为2025年12月31日），并综合考虑当前行业形势、标的公司财务与经营情况等因素，经双方友好协商后确定本次股权转让标的股权对应的转让价格为人民币4,000.00万元。

受让方应于股权转让交割条件满足或被受让方豁免后10个工作日内向转让方一次性支付全部股转价款。

3、目标股权过户

本次股权转让在目标公司主管市场监督管理局的变更登记手续应由目标公司在受让方支付全部股权转让价款之日起20个工作日办理完成，各方应当全面配合受让方和目标公司完成本次股权转让的全部手续。

自受让方支付全额股转价款之日（“交割日”）起，受让方即成为目标股权的合法所有者，对目标股权享有完整的权利，并承担相应的义务；转让方不再享有目标股权的股东权利，也不再就目标股权承担任何义务。

4、相关税费

转让方、受让方应各自承担本次股权转让所涉及的各项税费；目标公司应承担本次股权转让所涉及的股权过户登记相关费用。

5、协议的生效

本协议经各方签字或盖章后，于协议首页所述日期生效。

6、违约责任

除本协议另有约定外，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约，违约方应及时纠正其违约行为，且应赔偿由此给其他守约方造成的损失。

7、争议解决及管辖

凡因本协议产生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决；如在任何一方向其他方发出通知之日起的30日内不能通过协商解决争议，则任何一方均有权将该争议提交至目标公司所在地有管辖权的人民法院进行诉讼。诉讼期间，除争议事项外，各方可继续行使其各自在本协议项下的其他权利并应履行其各自在本协议项下的其他义务。

（二）交易涉及对方或其他方向公司支付款项的，董事会需要对付款方的支付能力及该等款项收回的或有风险作出判断和说明。

本次交易涉及苏州固锝向公司支付款项，苏州固锝依法存续经营，财务状况良好，具备良好的履约能力和支付能力，董事会认为其不存在重大履约风险。

六、出售资产对公司的影响

（一）交易对公司未来财务状况和经营成果的影响。

本次出售参股公司股权是基于公司发展实际情况的综合考虑，如本次交易顺利实施，将有利于提高公司资产运营效率、降低管理成本、增强公司的持续经营能力，为公司业务拓展提供资金支持。经初步测算，本次交易预计将为公司带来不低于2,800万元的股权转让收益，相关收益将确认为当期损益。公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上述股权转让款进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计确认后的结果为准。

本次交易完成后公司仍继续持有德信芯片7.5757%股权，与德信芯片将继续保持相关领域的业务合作。本次出售参股公司股权事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）交易所涉及标的的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

本次交易前，公司向标的公司委派了一位董事和一位监事；本次交易完成后，公司将不再委派董事，本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

（三）交易完成后是否可能产生关联交易的说明。

本次交易不涉及关联交易。本次交易完成后，如果公司未来与德信芯片的业务构成关联交易，公司将严格遵守上海证券交易所、《公司章程》等有关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

（四）本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施。

本次交易不存在同业竞争的情形。

（五）公司因出售资产将导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的，需要明确解决方案，并在相关交易实施完成前解决。

本次交易不存在上述相关情形。

七、风险提示

本次交易尚需提交公司股东会审议，相关方需按照协议约定支付转让款和办理标的公司股份过户手续，本次交易最终能否成功实施尚存在不确定性。本次交易对方具备履约能力，但依然存在不能按协议约定及时支付股份转让对价的履